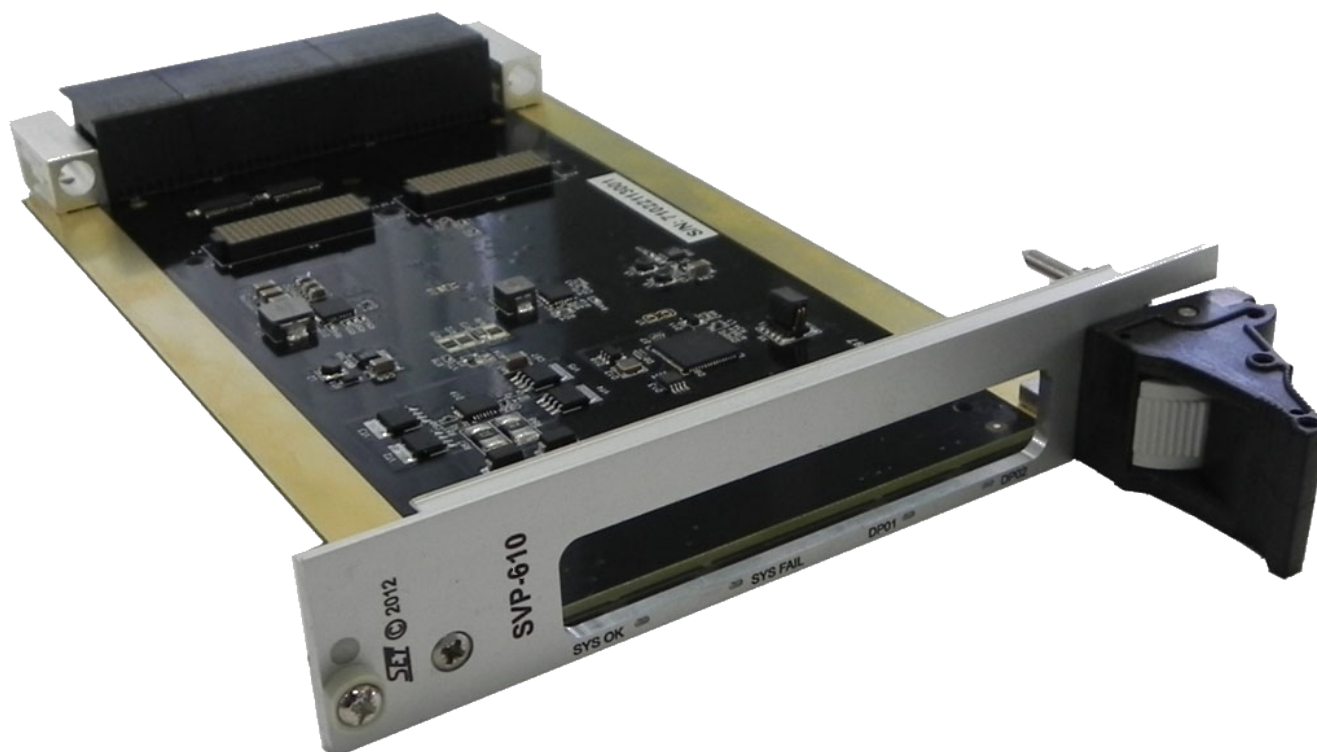


# SVP-610

Несущий модуль для submodule XMC  
форм-фактора VPX 3U



## Основные особенности

- Интерфейс: 1 × PCI Express x4 / Serial RapidIO x4 / 10 Gigabit Ethernet / и т. д. через разъём VPX (пластины 1–4 или пластины 5–8) (программируемая опция)
- Модуль форм-фактора VPX 3U, соответствующий стандартам: ANSI/VITA 46.0-2013 (воздушное охлаждение), ANSI/VITA 46.4-2012, ANSI/VITA 46.9-2010 и ANSI/VITA 65-2010 (R2012)
- Поддержка интерфейсов: PCI Express / Serial RapidIO / MGT x4 для XMC

## Обзор модуля

### Особенности

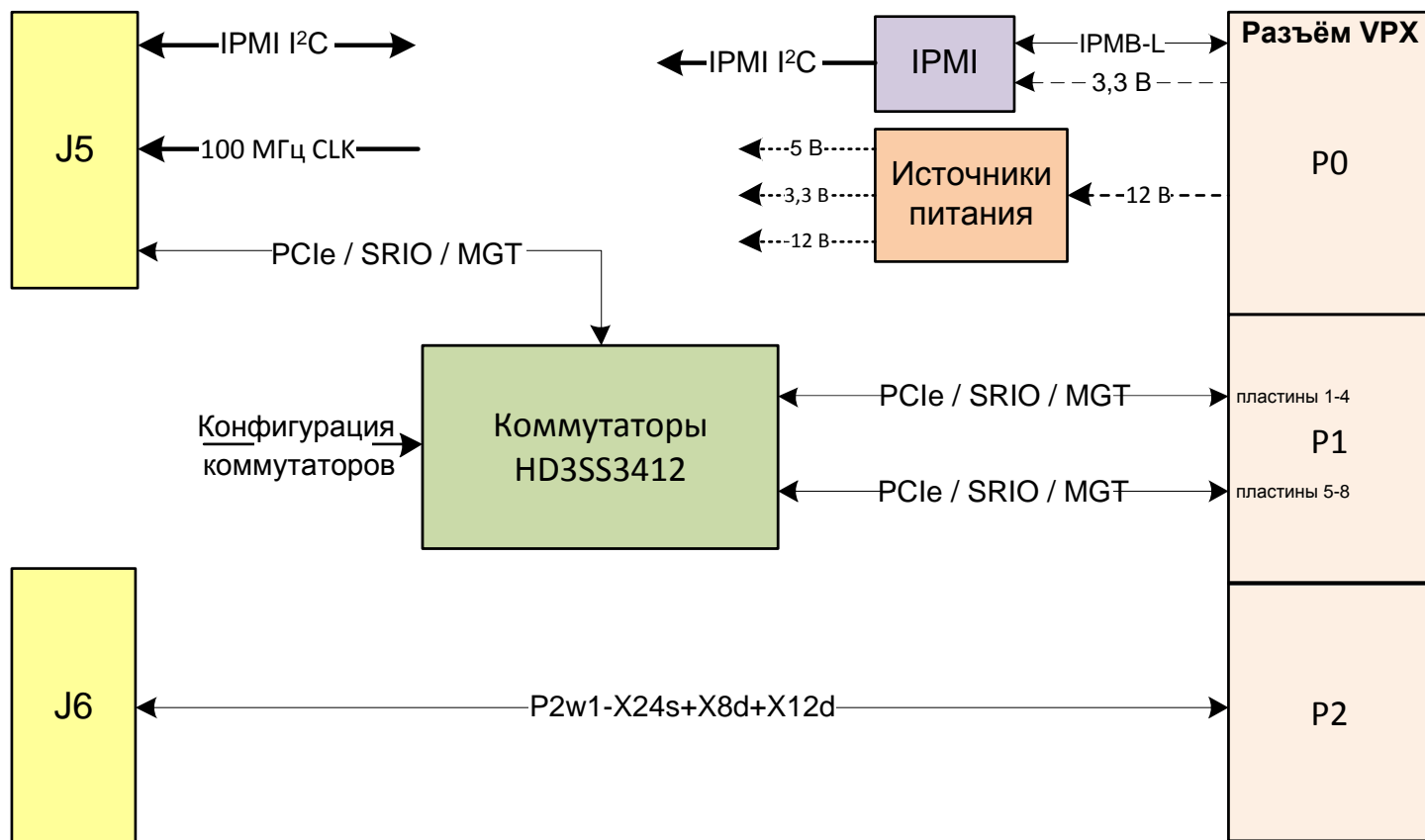
Модуль SVP-610 — несущая плата конструктива VPX в форм-факторе 3U с гибкими коммутационными возможностями и с широким диапазоном рабочих температур. Конструктивное исполнение SVP-610 соответствует стандартам: ANSI/VITA 46.0-2013 VPX Base Standard (воздушное охлаждение), ANSI/VITA 46.4-2012 PCI Express on the VPX Fabric Connector, ANSI/VITA 46.9-2010 PMC/XMC Rear I/O Fabric Signal Mapping on 3U and 6U VPX Modules Standard и ANSI/VITA 65-2010 (R2012) OpenVPX System Standard и позволяет встраивать в VPX систему широкую гамму готовых submodule XMC единичной ширины.

Для модулей XMC реализуются высокопроизводительные последовательные интерфейсы: PCI Express 3.0 x4, Serial RapidIO или MGT. Для модулей XMC выведены I/O в соответствии со стандартом VITA 46.9-2010, шаблон: P2w1-X24s+X8d+X12d.

### Области применения

Несущая плата предназначена для создания систем сбора и цифровой обработки сигналов, во встраиваемых в приборы, либо на базе промышленных компьютеров, соответствующих ANSI/VITA 46.0-2013 VPX Base Standard.

## Функциональная блок-схема



## Технические характеристики

### Интерфейсные контроллеры

Коммутатор Texas HD3SS3412: коммутация 2 × PCI Express x4 / Serial RapidIO / MGT от разъёма VPX P1 к разъёму J5 субмодуля XMC

### Субмодули

Поддержка установки субмодуля XMC: шина PCI Express x4 / Serial RapidIO / MGT, сигналы I/O выведены на разъём VPX P2

### Система мониторинга и управления IPMI

Автоматическое отключение питания при возникновении серьёзных сбоев на модуле

Мониторинг температур и напряжений питания модуля

Ведение журнала учета отказов блоков системы

Возможность удаленного контроля и управления модулем

Возможность «горячего» обновления и восстановления программного обеспечения IPMI без нарушения работы модуля

Поддержка «горячей замены» (Hot Swap)

### Соответствие стандартам

ANSI/VITA 46.0-2013 VPX Base Standard (воздушное охлаждение)

ANSI/VITA 46.4-2012 PCI Express on the VPX Fabric Connector

ANSI/VITA 46.9-2010 PMC/XMC Rear I/O Fabric Signal Mapping on 3U and 6U VPX Modules Standard

ANSI/VITA 65-2010 (R2012) OpenVPX System Standard

Шаблон: P2w1-X24s+X8d+X12d

IPMI v. 1.5 с поддержкой служебных функций

### Разъёмы VPX

Разъём P0

- 1 × IPMI-L.

Разъём P1

- 2 × PCI Express x4 / Serial RapidIO / MGT (пластины 1–8).

Разъём P2

- Сигналы I/O субмодуля XMC (разъём VPX P2, P2w1-X24s+X8d+X12d).

### Энергопотребление

Потребляемая мощность несущего модуля: не более 41 Вт

Распределение потребляемой мощности по линиям питания:

- +12 В (VS1): до 3,3 А (40 Вт);
- +3,3 В\_AUX (VS3): до 0,1 А (0,33 Вт) (питание IPMI).

### Условия эксплуатации

Охлаждение: воздушное или кондуктивное

Диапазон рабочих температур: коммерческий (0...+50 °C) или промышленный (-40...+85 °C)

Температура хранения: -50...+100 °C

Влажность: 10–95 % без конденсата

Возможность нанесения влагозащитного покрытия для жёстких условий

### Размеры

Форм-фактор: VPX 3U

Размеры: 160 × 100 × 25,06 мм

## Информация для заказа

**I**

Исполнение (температурный диапазон)

**T0:** Коммерческое (0...+50 °С)**T1:** Индустриальное (-40...+85 °С)**II**

Покрытие

**CV0:** Без влагозащитного покрытия**CV1:** С влагозащитным покрытием**III**

Охлаждение

**CL0:** Воздушное**CL1:** КондуктивноеПример кода изделия: **SVP-610-T1-CV1-CL1****SVP-610** — Несущий модуль для submodule XMC форм-фактора VPX 3UИсполнение (температурный диапазон): *Индустриальное (-40...+85 °С)*Покрытие: *С влагозащитным покрытием*Охлаждение: *Кондуктивное*

Возможны другие конфигурации модуля по индивидуальному запросу. За дополнительной информацией обращайтесь в SET.

## Контактная информация



ЗАО «Скан Инжиниринг Телеком»  
Россия, 394030, г. Воронеж, ул. Свободы, 75  
Тел.: +7 (473) 272-71-01, факс.: +7 (473) 251-21-99  
[www.setdsp.ru](http://www.setdsp.ru)

Электронная почта:  
Отдел продаж: [sales@setdsp.ru](mailto:sales@setdsp.ru)

ООО «Скан Инжиниринг Телеком - СПб»  
Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, 22-я линия В.О., д. 3, корп. 1, лит. М.  
Тел.: +7 (812) 406-99-95, +7 (812) 406-99-96  
[www.setdsp.ru](http://www.setdsp.ru)

Электронная почта:  
Отдел продаж: [sales.spb@setdsp.ru](mailto:sales.spb@setdsp.ru)